INVESTOR
RELATIONS

DUKSAN
Hi-Metal

2026년 3분기 IR Book

Company Overview · Technology · 3Q Earnings

KOSDAQ 069330

Strictly Confidential

CONTENTS

PART I

회사 및 사업 소개

Company · Business · Technology

PART II

2026년 3분기 실적

Highlights · Earnings

01

PART I

회사 및 사업 소개

Company · Business · Technology

Profile · Products · Process · M/S Position · Customers

덕산하이메탈 회사 개요

반도체 패키징 솔더볼 글로벌 리더 · Korea No.1 · Global No.1 in MSB

DS Hi-Metal

반도체 패키징 소재 일괄 생산 체계

Micro Solder Ball	Solder Ball	30μm 기술
글로벌 탑 티어 수준	국내 M/S 70%	초미세 대응 가능

일관 생산 체계 · 합성→ 정제→ 분급→ 도금→ 출하

305 명
임직원 (26.1Q)

577 억
2Q 매출액

87 억
2Q 영업이익

Corporate Profile

설립일	**1999년 5월**
상장	**KOSDAQ (2005)**
대표이사	**이수훈 · 김태수**
본사	**울산광역시 북구**
자본금	**9,087 백만원**
주요 제품	**SB · MSB · CSB · P&F**
고객사	**삼성전자, SK하이닉스, Amkor 등**

* 기준일: 2026년 3월말

Why DSHM? MSB 글로벌 경쟁 우위 · SB P-Q 상승 사이클 진입 · P&F 수익 구조 개선 · 고객사 Capa 증설

제품 포트폴리오 & 시장 지위

4대 핵심 제품군 · 반도체 패키징 솔 공정 소재 라인업

SB

Solder Ball

메모리/비메모리 반도체 패키징용
구형 솔더 소재(≤760μm)

2Q 매출

334 억

+117% YoY

Market Position

국내 70%

P,Q 상승 사이클

MSB

Micro Solder Ball

FC-BGA · AI칩 · HDD용
초정밀 미세 볼 (≤150μm))

2Q 매출

117억

+64% YoY

Market Position

글로벌 Top-tier

핵심 성장 엔진

CSB

Cored Solder Ball

AP 패키징용
고성능 Cu Core 솔더

Market Position

글로벌 A 社, S 社 등

라인 증설

P&F 등

Paste & Flux

SMT · Wafer Bumping용
페이스트 & 플럭스

2Q 매출

126 억

+53% YoY

Market Position

국내 S 社 등

✓ 수익 구조 개선

*2Q 26 별도 매출 577 억 (+88% YoY) · **MSB 성장세 유지** · P&F 구조적 수익 개선 진행 中*

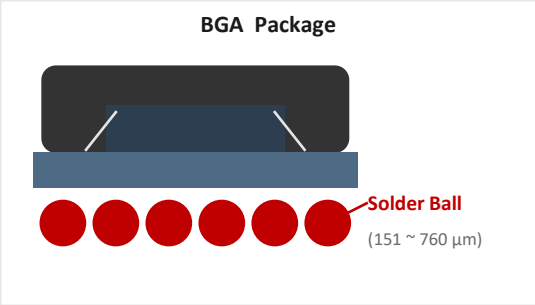
핵심 솔더볼 제품군 · SB / MSB / CSB

반도체 패키징 핵심 소재 · 글로벌 최고 수준의 고순도 정제기술력 — 30μm 초미세 대응 가능

SB Solder Ball

151 ~ 760 μm

BGA, BOC(FBGA), FCBGA, CSP, SiP, 2.5/3D Package 등



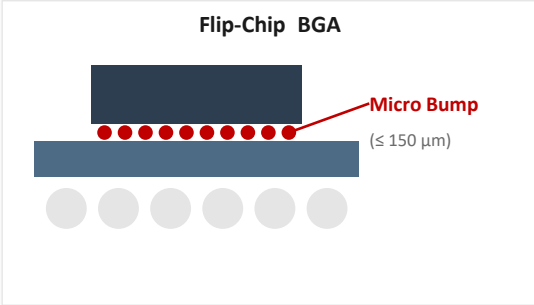
국내 M/S 70%

End-Use: 메모리 (DRAM · NAND) · CPU · GPU · ASIC 등

MSB Micro Solder Ball

≤ 150 μm (30μm 대응)

FC-BGA · HDD · FCCSP 등



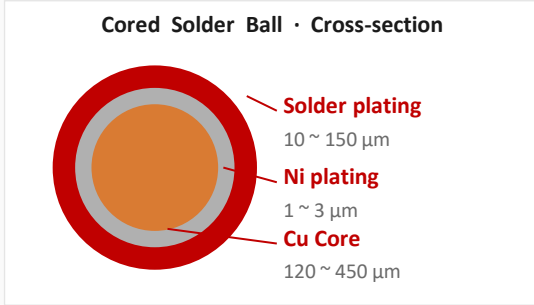
글로벌 M/S 선도

End-Use: AI 가속기 · CPU · HDD 등

CSB Cored Solder Ball

Cu Core 120 ~ 450 μm

AP 패키징(PoP · FOWLP/PLP) · 2.5D Package



글로벌 A 社

End-Use: Mobile AP 등

2Q26 별도 매출 577억 — SB 334억 (58%) · MSB/CSB 117억 (20%) · P&F·기타 126억 (22%)

MSB 글로벌 차별화 기술 기반 글로벌 경쟁 우위 확보 · 고객사 Capa 증설 · 수익 구조 개선

Solder Paste & Powder · 접합용 소재

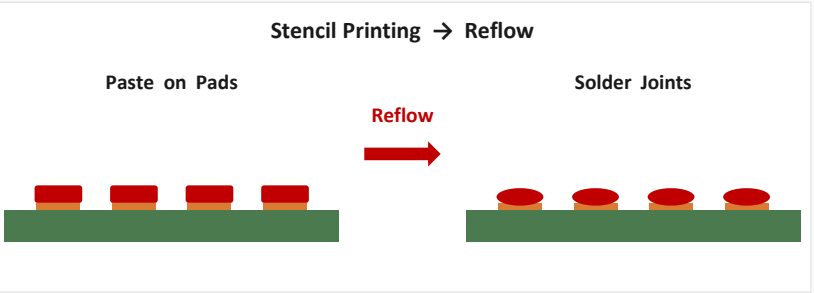
Flux + Powder 합금을 혼합한 크림형태 접합 소재 · 수익 구조 개선

PASTE Solder Paste · 접합용 소재

Flux + Powder 합금 분말을 혼합한 크림형태 접합 소재

Wafer Bumping用 · Solder Ball 대체 (Bump 형성 / Pre-solder)

SMT用 · 기판 ↔ 디바이스 접합 / 산화 방지

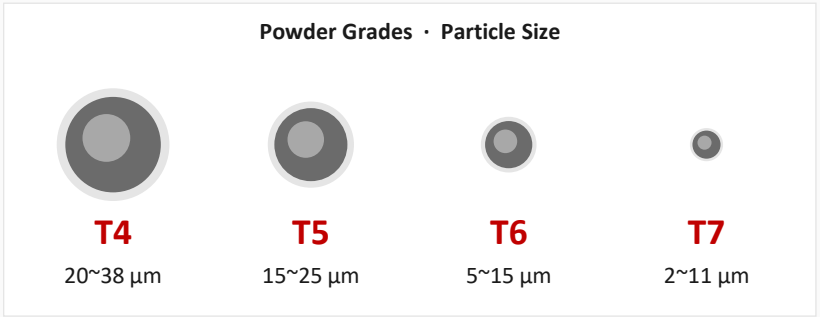


국내 S社 등 주요 SMT 고객 · 판가 인상으로 수익구조 개선

POWDER Solder Powder · T4 / T5 / T6 / T7

용도별 입자 사이즈로 분급된 초미세 솔더 분말

T4 (큼) → T7 (가장 미세) · 자체 합금 활용



T4~T7 분급된 초미세 분말 · Solder Paste 원재료 → 글로벌 SMT 고객사

현재 P&F는 Type 4/5 (IT 제품向) 위주 저수익 라인업

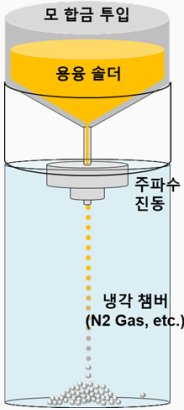
고객사 국산화 수요에 대응해 Type 6/7과 같은 고부가가치 다품종 라인업 개발 추진

공정 과정 · 자체 개발 PAP 공법 + 자동화 시스템

Pulsated Atomization Process (PAP) · 4단계 자동화 공정으로 30μm 초미세 솔더볼 양산

01 Pulsated Atomization

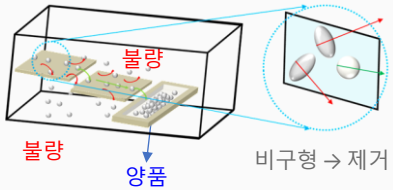
원료 투입 → 분사



· Frequency 제어
· Voltage 제어
· Temp 제어
· Pressure 제어

02 1st Sorting · Rounding

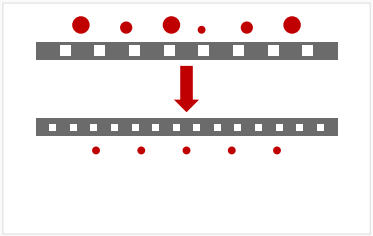
1차 선별 (구형도)



· 코팅 플레이트 위에서 회전
· 비구형 볼 제거
· 구형도 향상

03 2nd Sorting · Sizing

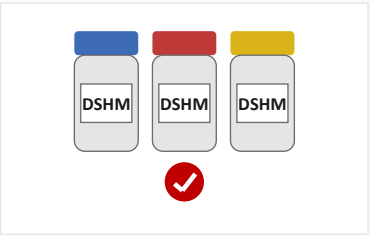
2차 선별 (크기)



· 다단 메쉬 통과로 사이즈 분류
· 균일도 확보

04 QC / Packaging

검사 / 포장



· Weight / Quantity / Visual
· PK1 (Packing) → OQC1
· PK2 (Boxing) → OQC2

Capacity · SB (SB + MSB + CSB) 약 20억 K / 月 · SB/CSB 라인 증설
자체 PAP 공법 + 자동화 라인 · 글로벌 최고 수준 고순도 정제기술력으로 30μm 초미세까지 양산

MSB 글로벌 시장 지위

Micro Solder Ball Global Top-tier · 30μm 초미세 기술 압도적 우위

Global MSB Market Share · 2025



Competitive Edge

01 초미세 기술력 — **≤ 30μm** 초정밀 대응

FC-BGA용 초미세 솔더 대응 → 글로벌 경쟁사 대비 입자 기술력 우위

02 전방시장 동시 수혜 — **AI + HDD** Dual Demand

FC-BGA(AI 가속기·ASIC) + HDD 레코딩 헤드용 수요 동시 견인
→ 국내외 글로벌 고객사 양산 확대 사이클

03 Lock-in 고객 구조 — **국내 기판 관련 기업 +** 글로벌 OSAT

핵심고객사인 국내 S社의 Full Capa 수혜 / 글로벌 고객사 M/S 확대
→ 일본, 중국 등 신규 고객사 확대 추진

AI 인프라 투자 가속 + HDD 쇼티지 + 메모리 패키징 수요 확대 → 3대 동시 수혜 구간 진입

최종 적용처 분석 · 제품 → End Product

AI · Memory · Mobile AP · HDD · SMT

SB

APPLIED TO

- 메모리 패키징 (DRAM · NAND)
- CPU · 일반 SoC
- Network ASIC
- Power IC · MCU

메모리 수요 + DDR5 전환 + AI 서버향 수요 증가

MSB

APPLIED TO

- FC-BGA (서버 · 데이터센터)
- HDD

AI 서버향 수요 증가 수혜

CSB

APPLIED TO

- Mobile AP (FC-PoP)
- 2.5D Package (Warpage 개선)
- 고밀도 BGA
- 특수용도 패키지

글로벌 A社 양산 · 글로벌 AP 제조사

P&F

APPLIED TO

- MLCC · 일반 SMT
- Bumping用 Paste

Type 6/7 신제품 개발 추진

Growth Theme · AI 인프라 확산 → 향후 MSB(FC-BGA·GPU) + CSB(2.5D 패키지) 동반 성장 기대

향후 자동차 / 데이터센터 / 모바일 등 응용처별 제품 다각화로 안정 성장 기반 구축 추진

주요 고객사 매트릭스 · 제품·지역별 분포

제품군별 핵심 고객 5~10社 · Top 5 고객사 매출 비중 49.9% 수준 · 국내 IDM·OSAT 중심 + 글로벌 분산

PRODUCT × KEY CUSTOMERS

SB	**삼성전자 · SK하이닉스 · Amkor 등** Korea IDM/OSAT + 글로벌 OSAT
MSB	**글로벌 OSAT** 글로벌 M/S 선도 · HDD + FC-BGA 패키징 중심
CSB	**글로벌 OSAT** 모바일 AP
P&F	**국내 S社 · 기타 SMT 고객** 수익구조 개선

GEOGRAPHIC DISTRIBUTION



Top 5 고객 매출 집중도

5대 매출처 합산 약 49.94%

고객 다각화 진행 中 · CSB 단일 고객 의존 → 신규 고객 확보 추진

신규 샘플 진행 · 주요 신규 거래처 샘플 진행 中 (SB·MSB·CSB)

자회사 소개

방산·우주항공 (덕산넵코어스) + 가스용기 (덕산에테르씨티)

방산 · 우주항공

덕산넵코어스

DS Nepcore · 지분 63.2%

2025 연간 매출	2Q26 매출
485억	118억

사업 영역

항법 / 항재밍 솔루션

- 육·해·공 무기체계 항법정보 (8대 무기체계 적용)
- 항법/항재밍 기술 기반 제품
- 글로벌 Top-tier 수준 항재밍 기술력

주요 고객 · 국내 방산/우주 항공 관련 기업(국내 H사, L사 등)

가스용기

덕산에테르씨티

Aether CT · 지분 91.9%

2025 연간 매출	2Q26 매출
617억	213억

사업 영역

특수가스용기 / 산업가스용기 / 수소용기

- 수소·반도체·우주항공용 특수가스 용기 제조
- Type 1 ~ Type 4 수소용기 全 라인업
- 수소 Value-Chain 전 영역 Coverage

주요 고객 · SK스페셜티 · 원익머트리얼즈 · 린데코리아 · 北京 Peric 등

연결 포트폴리오 · 하이메탈 (반도체 소재) + 덕산넵코어스 + 덕산에테르씨티 — 3대 사업부

2Q26 단순합산 매출 · 하이메탈 577억 + 넵코어스 118억 + 에테르씨티 213억 = 908억

02

PART II

2026년 3분기 실적

Earnings

Highlights · Earnings

3Q 2026 핵심 지표

연결 매출 995억 · 영업이익 102억

995	102	2,591	10.3
3Q 매출액	3Q 영업이익	1~3분기 누적 매출액	% · OPM
yoy +62%	yoy +553%	yoy +59%	yoy +7.7%pt

✓ HIGH-LIGHT

분기 사상 최대 매출 재갱신

판가 인상 안착 · 전 제품군 전년 대비 물량 성장

MSB 이익 중심축 지속

고수익 품목 비중 확대 · 글로벌 HDD·FC-BGA 수요 호조

CSB 신제품 램프 개시

신규 제품 양산 진입

⚠ WATCH-LIST

환율 변동 (원화 강세) 영향

원화 강세로 외화 매출 환산액 감소

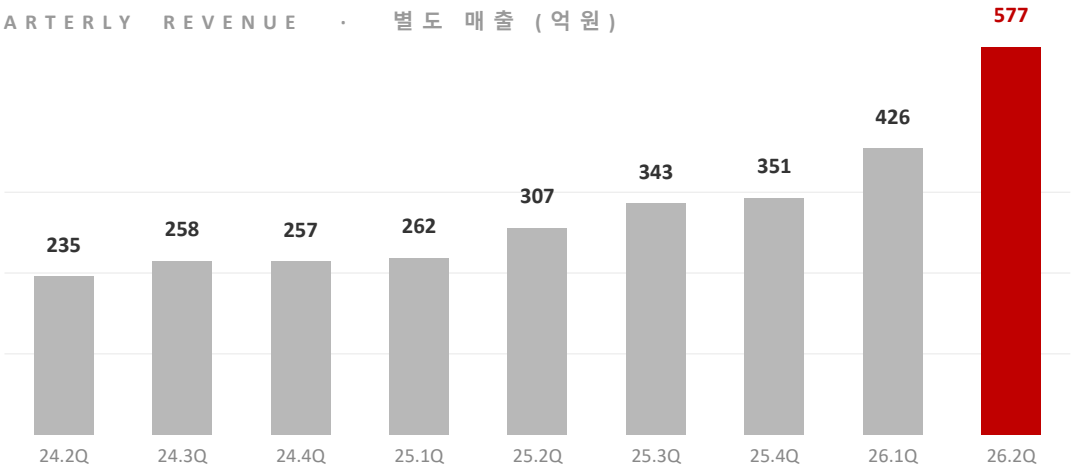
제품 믹스 변화 (Big Size 솔더볼 비중 확대)

Big Size SB 제품 비중 확대에 따른 재료비율 상승 · 판가 연동 구조로 관리

분기별 실적 추이 · 별도 기준

9개 분기 매출 +145% 성장 (235 → 577억)

QUARTERLY REVENUE · 별도 매출 (억원)



OPM (%)

24.2Q	24.3Q	24.4Q	25.1Q	25.2Q	25.3Q	25.4Q	26.1Q	26.2Q
13.3%	6.5%	44.1%*	11.8%	15.2%	13.0%	9.6%	5.4%	15.0%

* 24.4Q 일회성 항목 포함

MIX · 2Q25 vs 2Q26 (억원)

	2Q25	2Q26	YoY
SB	154	334	+117%
MSB + CSB	71	117	+64%
P&F·기타	82	126	+53%
합 계	307	577	+88%

9개 분기 추세 · 매출 +145% 성장 + 분기 사상 최대 매출·이익 동시 갱신

SB 판가 인상 + MSB 마진 레벨업 견인 · CSB 신제품 램프는 4Q 본격화

연결 실적 · 자회사 포함

2Q26 단순합산 매출 908억 (+58% YoY) · 연결 영업이익 101억 (QoQ 흑자전환)

CONSOLIDATED · 2Q25 / 1Q26 / 2Q26 (억 원)

구분	2Q25	1Q26	2Q26	YoY	QoQ
매출 합산	574	687	**908**	+58%	+32%
하이메탈	307	426	577	+88%	+35%
넵코어스	125	120	118	-6%	-1%
에테르씨티	142	141	213	+50%	+51%
영업이익 합산	48	6	**113**	+136%	+1,871%
하이메탈	47	23	87	+86%	+279%
넵코어스	16	2	5	-68%	+131%
에테르씨티	-15	-19	21	흑전	흑전
기타/연결조정	*-22*	*-13*	*-12*	-	-
연결 영업이익	**26**	**-7**	**101**	**+291%**	**흑전**

SUBSIDIARIES · 2Q26 ISSUES

덕산넵코어스 매출 118억 · 영익 5억

+ 코스닥 상장 완료 (26.9월)
+ 방산 양산 매출 견조 · 상반기 매출 238억 (+18% YoY)
– 2Q 영업이익 YoY 감소 (16억 → 5억)

덕산에테르씨티 매출 213억 · 영익 21억 (흑자전환)

+ 특수가스 판매 회복 — 매출 YoY +50% 성장
+ 전년 적자(-15억)에서 흑자전환 · 수익 구조 개선
+ 재고 운영 효율화 및 수익성 개선 활동 지속
+ 수소·산업가스 등 신규 수주 활동 강화

Key Takeaway · 본업 하이메탈 분기 사상 최대 + 자회사 동반 개선 — 연결 영업이익 101억 흑자전환 · 넵코어스 코스닥 상장으로 성장축 확대

투자 유의사항

DUKSAN

Hi-Metal

2026 3Q IR Report

CONTACT

Head of IR/PR Group
Dong Jun Shin
peter1110@oneduksan.com

Seon Jong Park
sunny.park@oneduksan.com
T. 070-5066-2770

www.dshm.co.kr

투자 유의사항

본 자료에 기술되어 있는 2026년 실적은 K-IFRS 기준의 내용입니다. 본 자료는 투자자들에게 정보 제공을 목적으로 덕산홀딩스㈜(이하 회사)에서 작성되었습니다. 해당 자료의 반출, 복사 또는 타인에 대한 재배포는 금지 됨을 알려드립니다.

또한 본 자료는 미래의 불확실성 및 위험 요인에 따라 변경될 수 있는 가정에 근거한 특정 정보를 포함하고 있습니다. 이는 세계 경제와 그에 따른 트렌드, 시장 전략 및 사업 계획 등의 미래 투자 계획을 포함합니다. 이러한 가정과 환경의 변화로 인한 변동 사항에 대하여는 당사의 책임이 없음을 양지하시길 바랍니다.

회사의 실제 실적은 당사가 예측하지 못할 수 있는 요소들로 인해 변경될 수 있습니다. 이러한 요소는 경제 침체의 심화, 고객 수요의 감소, 주요 고객의 이탈, 가격 하락 압박, 특정 프로젝트 및 설비투자에 대한 자금 조달 상의 문제 등을 포함합니다.

본 자료에 포함된 재무 정보는 외부감사인의 회계 감사가 완료되지 않은 상태에서 투자자 여러분의 편의를 위해 작성된 자료이므로, 감사 후 실제 실적에는 변동이 생길 수 있음을 양지하시길 바랍니다.